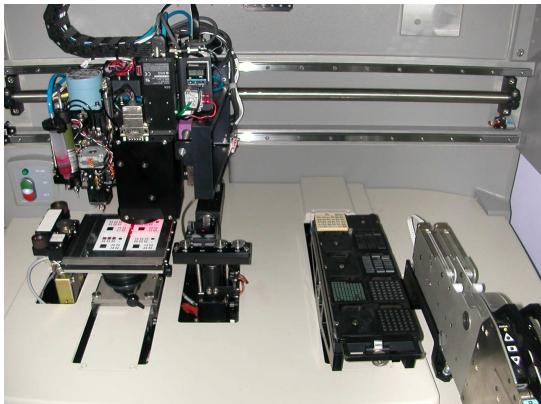


微组装技术有限公司



执行MCM、混合、倒装芯片、共晶、银玻璃芯片的贴片应用。

多功能、用户友好的设备，基于PC平台Windows XP®运行。

全自动系统设计，灵活性高、操作方便。

高精度闭环伺服系统控制胶头X、Y方向运动。

高分辨率数字视觉与图像处理系统。

通过体积分配器，粘合剂可以应用于单/多点和形状模式。复杂的预教分配形状库。

冲压（引脚转换） $75 \mu m$ 及以下的粘接点。

独有的1次通过，湿片堆叠能力与块材的BLT控制。

芯片：

- 多达30个网格板/凝胶包。
- 多达8个磁带和卷轴馈线。
- 300 mm晶圆

针对非常见的芯片尺寸和纵横比，可以连接CCD、传感器和其他传感元件。

可以处理 MEMS 器件。具有从晶圆拾取MEMS的经验，设计特殊的拾取工具和精确BLT控制密封。

全倒装芯片工艺，包括芯片翻转、凹凸通量和芯片仰视相机的最终对准。

加热基材与气体覆盖和加热拾取工具，用于共晶工艺。

超声波接头用于共晶和金到金互连。

规格参数

工作区：最大 10×12 英寸

芯片尺寸：0.008英寸到1英寸以上。

芯片材质：砷化镓、硅、玻璃、金属等。

拾取/粘合力：40至4000克。

精度： $3^{\star}m @ 3\sigma$ - 取决于应用。

产量：高达1000CPH。